



Solder Anchor Attachment Method

Part Number: 374824B60024

(Vis Number: 037813)

This part is in stock and available for immediate delivery:

Contact your [local sales rep](#)

BGA Surface	Interface	Heat Sink Finish	Part Class
All	T766	Black Anodize	A

Features and Benefits

- New unique wire clip design allows for complete reworkability after assembly
- Configurations are available for a wide range of BGA package sizes in any thickness up to 3.0mm
- Minimal PC Board real estate is required for mounting
- Solder Anchors provide the most rugged mounting in the industry
- Each Heat Sink utilizes a phase change pad as the interface for optimal performance



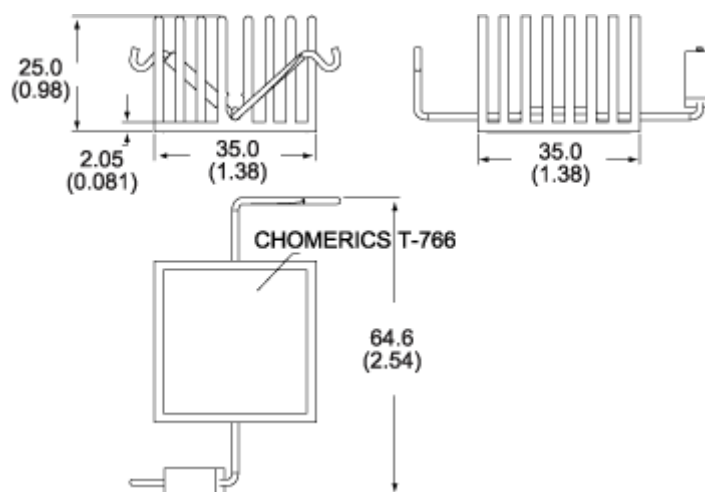
Solder anchors are sold separately

Part Number Do57

2 Solder anchors must be soldered to the PCB Prior to attaching the heat sink clip.

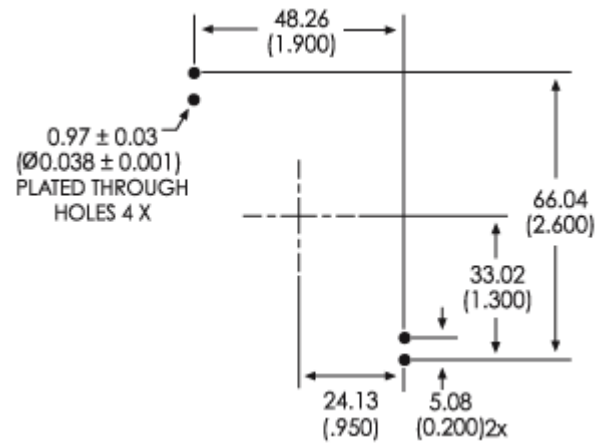
Width	Length	Height	Fin Thickness Across Width	Fin Thickness Across Length	Base Thickness	# of fins across width	# of fins across length
35mm	35mm	25mm	1.9mm	2.04mm	2.05mm	8	8

Mechanical Outline Drawing



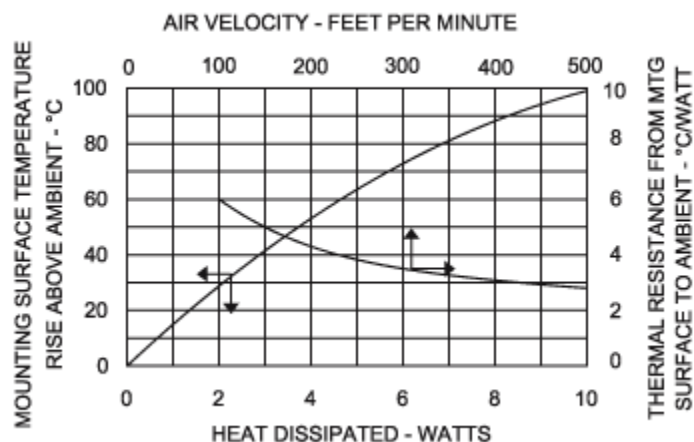
Unless otherwise shown, tolerances are $\pm 0.38(\pm .015)$

Recommended PCB Hole Pattern



Thermal Performance

* θ_n	** θ_f
12	4.27



*Natural convection thermal resistance is based on a 75 °C heat sink temperature rise.

**Forced convection thermal resistance based on an entering 1.0 m/s (200 lfm) airflow.
Due to various heat dissipation paths within a BGA device, please test the heat sink in your application.

This data sheet represents only one of a broad range of products we make to cool electronics.
Our representatives can help you configure a complete cooling solution for your individual applications.

Visit us at www.aavidthermalloy.com • info@aavid.com • ©2002 Aavid Thermalloy, LLC

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9